



# Xspection

柜式X光机检测系统

Xspection是一款采用平板探测器和大发射角的微焦斑X光管组合的高性能、高性价比的闭管X光机，它支持360度旋转，最大倾斜角度70度，可以升级为工业CT，是SMT(BGA)，航空航天，半导体等产品无损检测的最佳产品。

## 关于Xspection:

Xspection是一款采用平板探测器和大发射角的微焦斑X光管组合的高性能、高性价比的闭管X光机，它支持360度旋转，最大倾斜角度70度，可以升级为工业CT，是SMT(BGA)，航空航天，半导体等产品无损检测的最佳产品。

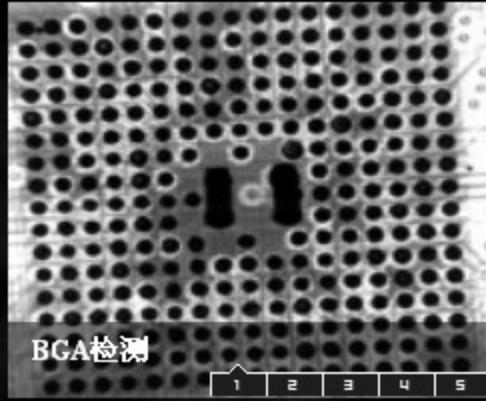
## 主要功能:

### 功能

- 130KV 3um封闭式光管
- 可以升级CT
- 高清的平板探测器
- 载物台尺寸：590\*450mm
- 最大倾斜角度70度

### 优势

- 大功率便于检测带屏蔽层的样品，检测精度接近1um
- 可以满足大型样品的检测
- 不需要倾斜样品，可以以独特的视角检测样品
- 放大倍数更大，图像清晰看BGA虚焊更容易
- 是一款性价比极高的x光机



## 应用:(点击应用链接, 查看效果图)

- 半导体封装
- 电子连接器模组的检测
- 封装元器件
- 铝压模铸件
- 陶瓷制品
- 航空组件
- 农业(种子筛选)
- 医疗制品

## 数控编程

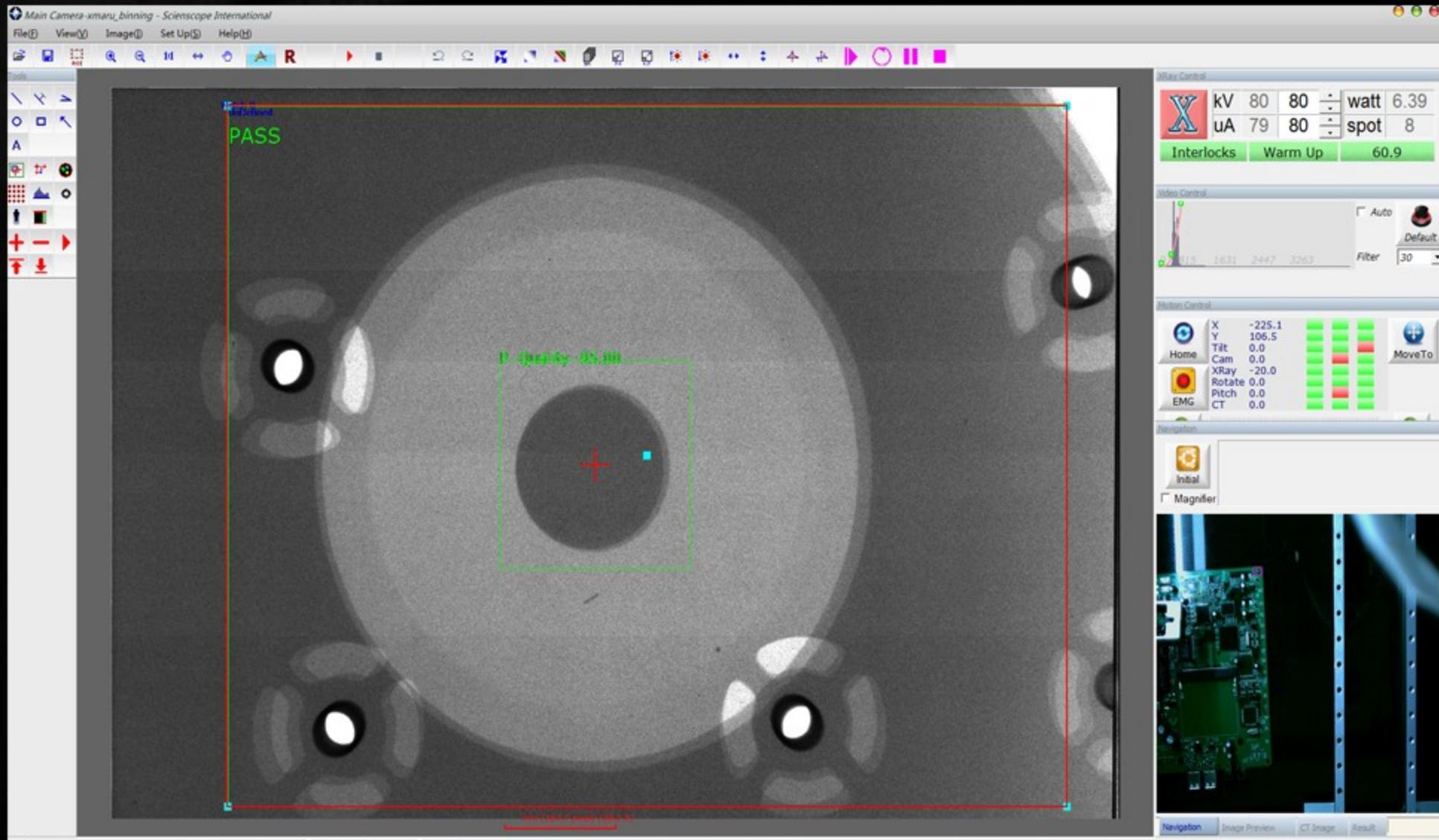
- 简单的鼠标点击操作编写检测程序
- 载物台可以进行X、Y、Z方向定位,X光管和X光探测器方向定位
- 计算机设置电压和电流
- 影像设定：亮度、对比度、自动增益和曝光度
- 用户可以设置程式切换的停顿时间
- 防碰撞系统可以满足最大限度的倾斜和观察物体

## 全自动BGA检测程序

- 简单的鼠标点击编辑允许在无需操作员干预的情况下自动检测组件上每一个BGA
- 自动BGA检查程序可精确检查BGA的桥接，虚焊，冷焊和空洞比例
- 自动BGA检测程序检测结果重复性高以便于制程监控
- 检测结果会显示在屏幕上并且可以输出到Excel表里方便复查和备案

## 标准配置:

- 超大尺寸的平板探测器
- 6轴联动，载物台可以360度旋转，相机最大倾角度为70度
- 强大的QA检测功能，全自动检测BGA焊接
- 130KV-3um的X光管
- 计算机控制电压和电流，配备24寸显示器
- 强大的分析软件功能，可以升级CT



# 规格说明

X-Ray Tube		
<b>Tube Style</b> (光管类型)		封闭管
<b>Tube voltage</b> (光管电压)		130kV(可选100KV、110KV)
<b>Tube current</b> (光管电流)		0.15mA
<b>Focal Spot Size</b> (光管聚焦尺寸)		3um
<b>Tube cooling</b> (冷却方式)		风冷
<b>Geometric magnification</b> (几何放大倍率)		200倍
<b>System Magnification</b> (系统放大倍率)		2000倍
数字平板探测器		
图像传输速度		20 FPS
<b>Resolution</b> (分辨率)		1000*1000、1500*1500
X-Ray Cabinet		
整机外观尺寸		1630mm (L) x 1850mm (W) x 1650mm (H)
载物台尺寸 (有效面积)		590mm x 450mm
载物台运动行程		Axis X (X轴) 360mm Axis Y (Y轴) 300mm Axis Z (Z轴) 增强屏行程:190mm、光源行程:90mm
<b>Weight</b> (重量)		约1400kg
Power		
<b>Automatic switching power supply</b>		AC 110 - 230 VAC 50/60 Hz
Computer		
<b>Operation System</b>		Windows XP/7
Warranty (保修期)		
<b>One year, parts and labor</b>		一年 (人为损害因素除外)